

WS-575-SP

倒装焊助焊剂

简介

WS-575-SP倒装焊助焊剂是一款专门为满足直接焊接细间距倒装芯片 (<0.5mm) 的应用设计。**WS-575-SP**的完全水洗型残留可避免与底部填充胶不兼容的问题。

特点

- 溶于水
- 无卤：无人为添加卤素
- 适用于喷涂应用
- 适用于锡铅、无铅和高温焊接
- 对焊点下的金属化表面无侵蚀作用

特性

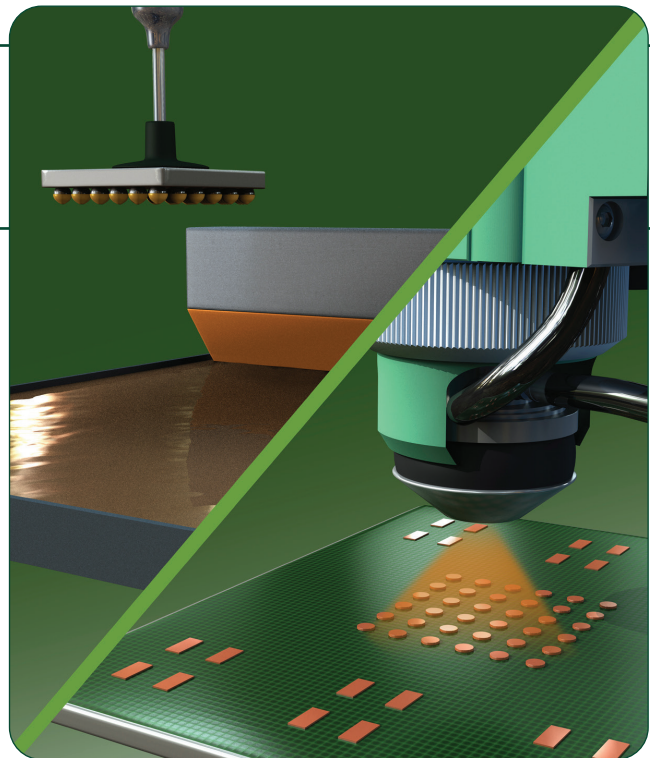
属性	数值	测试方法
助焊剂类型	M0	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.3.32和2.3.33)
典型黏度	45cSt	Cannon-Fenske黏度计
清洗后的表面绝缘电阻(欧姆)	合格(温度为85°C、相对湿度为85%的环境下7天, >10 ⁹)	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.6.3.3 IPC-B-24)
典型酸值	55mg KOH/g	滴定法
颜色	色泽介于琥珀色与褐色之间	直接观察
保质期	1年(0-30°C)	黏度变化/显微镜检查

所有信息仅供参考,不应被用作所订购产品性能和规格的说明。

应用

推荐的助焊剂量: 500–1,500 毫克/平方毫米,具体数值取决于倒装芯片。

喷涂: 助焊剂储存罐中应可以装下能供应8小时工作的用量。罐内剩余的助焊剂如果存放时间过长可能会失效(室温下可在罐内存放最高至10小时)。喷雾器需要经常清洗,从而能有效地保证此助焊剂或其他助焊剂的纯净度。



清洗

WS-575-SP可用去离子水或添加了清洗成分的清水清洗。喷雾清洗的最佳情况是在压力高于60psi、温度不低于25°C的条件下清洗1分钟以上。

包装

WS-575-SP按重量(克)出售。包装规格从100克到1加仑(3.8升)不等。可按需提供其他形式的包装。

储存

为达到最长的保质期, **WS-575-SP**不可在超过25°C的环境里存放超过4天,且储存温度绝不可以超过30°C。冷藏(最低可达-25°C)可以最大限度地延长保质期。使用前, **WS-575-SP**应提前至少4小时从冷库中取出并置于室温环境中。

技术支持

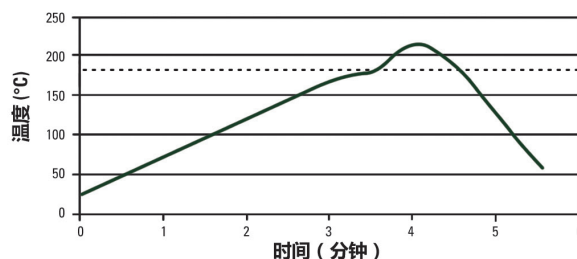
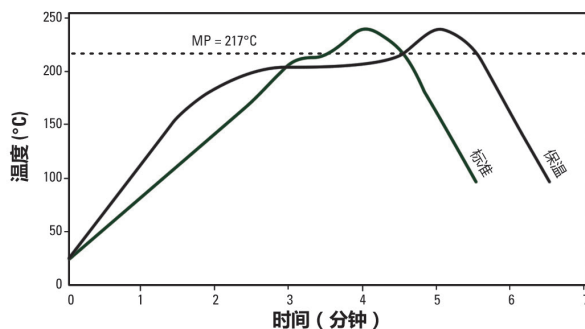
钢泰公司第一时间回应全球客户和坚持提供现场技术支持的高品质服务已成为行业标杆。钢泰公司的技术支持工程师为客户提供材料科学和半导体封装工艺应用领域的全方面的专业服务。

安全说明书

请参考随货品一起寄出的产品安全说明书, 或者联络钢泰公司当地的销售团队获取。

回流

推荐的回流曲线:



在空气或者氮气中回流 (建议氧气含量<10ppm), 其峰值温度应低于340°C, 线性升温不应超过液相线30°C。此回流曲线应作为应用的初始参考, 然后应根据特定工艺进行优化。

本产品说明书仅供参考, 并不对所描述的性能做任何担保。具体质保信息请参见产品合同、发票或者发货单里的文字说明。除特别说明, 钢泰公司的产品和解决方案均市场有售。

钢泰公司的所有焊锡膏和预成型焊片的生产工厂均通过IATF 16949: 2016认证。
钢泰公司是ISO 9001: 2015注册公司。

联系我们的工程师: china@indium.com

有关详情: www.indiumchina.cn

亚洲 +65 6268 8678 • 中国 +86 (0) 512 628 34900 • 欧洲 +44 (0) 1908 580400 • 美国 +1 315 853 4900



©2022钢泰公司